

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放

募集资金专户管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟终止的募投项目名称：年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目；
- 剩余募集资金使用计划：继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来，公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，同时，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否追加投资。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益；
- 本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会战略委员会第二次会议、于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，上述事项

尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募投项目的概述

（一）实际募集资金到位情况

公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金累计投入金额	投入进度	变动情况
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	19,887.36	45.60%	
2	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	7,861.10 （注 1）	71.04%（注 2）	拟终止
3	补充流动资金	20,000.00	20,113.00	100.57% （注 3）	
合计		74,681.19	47,861.46		

注 1：“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约 274.42 万元（前述金额系按合同计算，需根据合同实际履行情况确认，最终金额以项目实际支付为准）。

注 2：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 11 月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。

注 3：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

二、本次拟终止部分募投项目情况及原因

（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司，项目投资总额为 11,066.15 万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心，项目达产后，每年可生产测试分选机零配件及组件共 1,000 套。项目建成后新增测试分选机零配件精密加工的产能拟全部用于保障未来公司测试分选机生产的零配件及组件需求。

截至 2025 年 5 月 19 日，该项目募集资金累计投入金额 7,861.10 万元。目前主体建筑已竣工，并且已经取得房产证。

（二）拟终止部分募投项目的原因

1、公司产品介绍

公司主营业务为半导体测试分选机的研发、生产及销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

2、“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的设计背景

2021 年 6 月，随着下游客户需求的上升，公司需持续扩大分选机产能。公司产品集成电路分选机对于工位组成、主要工位机械结构、电气系统布局以及电机的选型与控制要求比较严格，对于零配件与整机的契合度要求较高。基于加强产品上游供应链的把控，提升供应链的稳定性，保障公司分选机产品供货的及时性以及缓解公司因业务量增多面临的零部件产能饱满问题等情形的考虑，公司决定开展“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”。

当时，公司尚处于规模有待增长的成长阶段，同时，可供公司选择的零配件及组件委外加工供应商面临的市场需求较好，基于前述原因，公司在零配件及组

件委外加工供应链管理中谈判地位较弱。而与公司合作的零配件及组件委外加工供应商，在加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等方面难以契合公司需求。经公司审慎评估，“公司自建机加工中心”生产零配件及组件既符合公司发展需求又同时具有成本效应。

本募投项目立项时，公司未发现本次终止募投项目原因的相关情形。

3、拟终止部分募投项目的原因

自 2021 年 6 月本募投项目立项至 2023 年 3 月公司上市，本募投项目立项时的行业政策、市场需求、技术路线、盈利预测等核心假设未发生实质性变化，因此，公司认为“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”必要性和可行性未发生重大变化，符合公司发展战略。

2023 年 10 月，基于国内外宏观经济形势波动、半导体行业周期性波动等因素影响，公司结合市场实际情况放缓了对“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的投资进度。公司已于 2023 年 10 月在履行必要审议程序后决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 11 月。

前次延期本募投项目达到预定可使用状态日期后，公司密切关注并持续评估本募投项目所处的宏观及微观条件。

一方面，2024 年以来，受宏观经济及贸易形势影响，公司可选择的零配件及组件委外加工供应商的订单量有所减少。公司零配件及组件委外加工供应商为提升与公司业务合作的稳定性，主动提高服务响应速度、确保交付准时率、优化合作条款，并且更加注重与公司的长期合作关系，如对于公司零配件及组件加工所需要的高精度专用设备的购买意愿增强。

另一方面，2024 年以来，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域企稳复苏。受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第一季度实现营业收入 1.29 亿元，较上年同期增长 45.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,565.85 万元，较上年同期增长 72.29%。

同时，基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所

交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。

公司则借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。部分供应商为配合公司零配件及组件制造相关需求，全面提升精密制造能力和快速响应能力，公司生产效率和资金使用效率得到进一步提升。

4、公司自建厂房生产零配件及组件与外采零配件及组件成本对比分析

根据公司测算，公司从外部供应商处采购一套测试分选机所需的零配件及组件的成本较公司自建厂房生产一套零配件及组件优惠约 1.50%。

综上，经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。

三、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途

本次募投项目终止后，公司拟将本次剩余募集资金（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来，一方面公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目；另一方面，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否存在追加投资的需求。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益。

四、对公司的影响

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理，未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项，是公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）履行的审议程序

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项，已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司终止“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，本事项尚需经股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日